

# COB実装技術

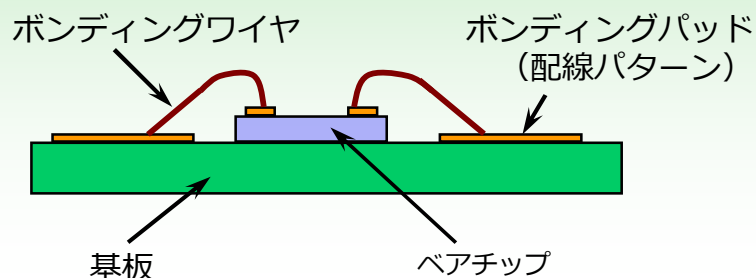
光山電気工業 ハイブリッドIC製品

弊社では、ベアチップ搭載を中心に電子部品の実装および組立の量産ラインを有しております。

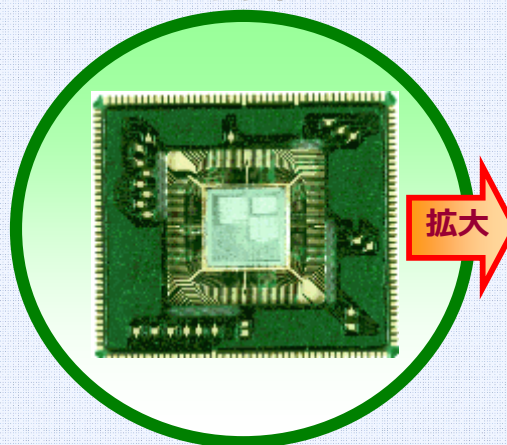
ワイヤボンディング実装、ダイボンディング実装、厚膜印刷、鉛フリー・共晶はんだ実装、など幅広い実装技術で部品調達から基板実装・完成品組立・検査までの一貫した業務をお受けいたします。

## COB ベアチップ搭載

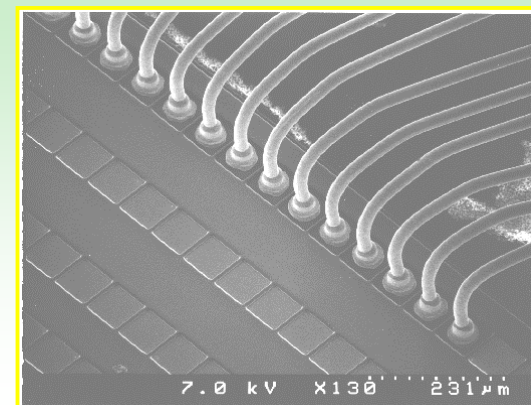
COB (Chip On Board) とは、LSIやICのベアチップを直接基板に搭載し、金ワイヤで配線する実装技術で小型・薄型のハイブリッドICが容易に実現できます。



## ベアチップ実装 ハイブリッドIC



## 80μmピッチ ワイヤボンディング例



## COB製造ライン

### ウエハーダイシング



### ダイボンディング



### ワイヤボンディング



### SMD 部品自動搭載



### 電気的特性検査



<http://www.kohzan.co.jp/akita/>

 光山電気工業株式会社